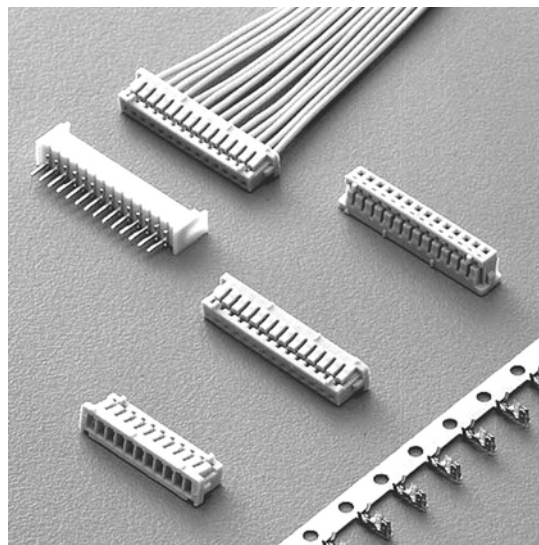


# Stift-/Buchsenleisten - Crimp-Rast-System - RM 1,25mm

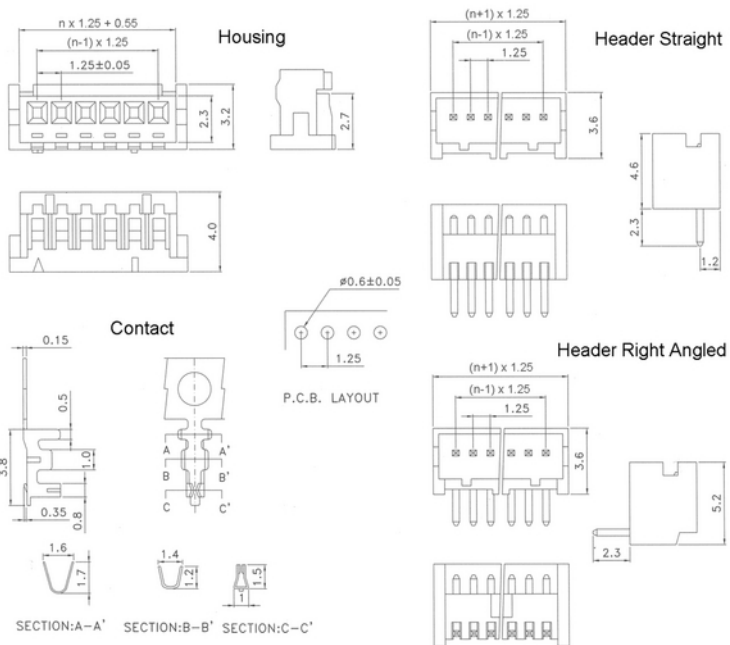
## Friction Lock Header and Crimp Housing - Pitch 1,25mm

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Messing, verzinnt
Contact Material	Brass, tin plated
Aderquerschnitt	AWG 28 ... 32
Applicable wire Gauge	AWG 28 ... 32
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 5x10 <sup>8</sup> Ω
Insulation Resistance	> 5x10 <sup>8</sup> Ω
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennspannung	100V <sub>AC/DC</sub> max.
Voltage Rating	100V <sub>AC/DC</sub> max.
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Wave soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS



Series

563

Contacts\*

15

02-15

Type\*

4

1 Buchsengehäuse  
Housing

2 Buchsenkontakte  
Crimp contacts

3 Stiftleiste gerade  
Straight pin header

4 Stiftleiste gewinkelt  
Right angled pin header

Plating

50

50 Verzinnt (für Gehäuse nicht erforderlich)  
Tin plated (not used for housings)

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre  
Spezifikationen ersetzen.

(\* Order example - To be replaced by your  
specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0  
FAX.: +49 5223 98507-50

# W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wppro.com  
INTERNET: www.wppro.com

# Informationen zum Wellenlötverfahren

## Wave Soldering Information

### Wellenlötverfahren Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei 260°C für max. 5 Sekunden verarbeitet werden.  
Items should be soldered at 260°C for max. 5 seconds.

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
Recommended wave soldering profile:

